



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN22930X

Issue Date: 21 Nov 2019

Title of Change:	TSOP5 NCP114 assembly material change at Leshan Phoenix Semiconductor, China.
Proposed First Ship date:	01 Oct 2020 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Jan.Gryzbon@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>
Marking of Parts/ Traceability of Change:	The affected products will be identified with date code.
Change Category:	Assembly Change
Change Sub-Category(s):	Material Change

Sites Affected:**ON Semiconductor Sites**

Leshan Phoenix Semiconductor, China

External Foundry/Subcon Sites

None

Description and Purpose:

Converting TSOP5 NCP114 from 0.8mil Au wire to 0.8mil Cu wire and from Leadframe option1 (Flag size 1.7mmx1.2mm) to Leadframe option 2 (Flag size 1.2mmx1.0mm) at Leshan Phoenix Semiconductor, China.

	Before Change Description	After Change Description
LeadFrame	Flag size 1.7mmx1.2mm	Flag size 1.2mmx1.0mm
LeadFrame diagram		
Bond Wire	0.8mil Au wire	0.8mil bare Cu wire

**Qualification Plan:****QV DEVICE NAME:** NCP114ASN330T1G**RMS:** 63969**PACKAGE:** TSOP5

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC+PC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +152°C	500 cyc
HAST+PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	
PD	JB100, ON DataSheet	-	
SAT	as outlined in MSB17722C	12MSB17722C	
ESD	12MSB17722C	HBM, CDM, IEC	
BS	AEC-Q100-001	Cpk 1.33, 30 bonds from 5units	
BPS	M883 Method 2011		500 cycles
ED	ON DataSheet	Cpk > 1.67 Test @ R, H, C	
DPA	AEC-Q101-004 Section 4	post 1X TC, 1X H3TRB/HAST	
Shift	AEC-Q100-009	Post 1X HTOL	

Estimated date for qualification completion: 9 May 2020

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
NCP114ASN080T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN120T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN120T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN150T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN150T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN180T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN180T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN250T1G	NCP114ASN330T1G



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN22930X

Issue Date: 21 Nov 2019

NCP114ASN250T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN260T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN270T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN280T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN280T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN290T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN300T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN330T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN330T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114BSN330T1G	NCP114ASN330T1G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22930X

発行日 : 21 Nov 2019

変更件名:	楽山工場(中国)における TSOP5 NCP114 の組み立て材料の変更	
初回出荷予定日:	1 October 2020 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)。	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Jan.Gryzbon@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がございましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
製品マーキング/変更のトレーサビリティ:	影響を受ける製品は、日付コードによって識別されます。	
変更カテゴリ:	アセンブリの変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: Leshan Phoenix Semiconductor, China	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし
説明および目的: 楽山工場(中国)において、TSOP5 NCP114 に対して、0.8mil Au ワイヤから 0.8mil Cu ワイヤへの変更、およびリードフレーム・オプション 1 (フラグサイズ 1.7mmx1.2mm) からリードフレーム・オプション 2 (フラグサイズ 1.2mmx1.0mm) への変更。		
	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Flag size 1.7mmx1.2mm	Flag size 1.2mmx1.0mm
リードフレーム図		
ボンドワイヤー	0.8mil Au wire	0.8mil bare Cu wire



認定計画:

デバイス名 : NCP114ASN330T1G

RMS: 63969

パッケージ: TSOP5

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC+PC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +152°C	500 cyc
HAST+PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	
PD	JB100, ON DataSheet	-	
SAT	as outlined in MSB17722C	12MSB17722C	
ESD	12MSB17722C	HBM, CDM, IEC	
BS	AEC-Q100-001	Cpk 1.33, 30 bonds from 5units	
BPS	M883 Method 2011		500 cycles
ED	ON DataSheet	Cpk > 1.67 Test @ R, H, C	
DPA	AEC-Q101-004 Section 4	post 1X TC, 1X H3TRB/HAST	
Shift	AEC-Q100-009	Post 1X HTOL	

認定完了予定日: 9 May 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NCP114BSN330T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN330T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN330T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN300T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN290T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN280T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN280T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN270T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN260T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN250T2G	NCP114ASN330T1G



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22930X

発行日 : 21 Nov 2019

NCP114ASN250T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN180T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN180T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN150T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN150T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN120T2G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN120T1G	NCP114ASN330T1G
NCP114ASN080T1G	NCP114ASN330T1G